

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

西安炬光科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-007

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☒其他（投资者现场调研/投资者开放日）
参与单位名称及人员姓名	9月参加公司现场调研的投资者（见附件）
会议时间	2026年9月1日-9月30日
会议地点	西安炬光科技股份有限公司、西安高新区万豪酒店（投资者开放日）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：刘兴胜 先生 董事、董事会秘书、市场总监：张雪峰 女士 副总裁、激光光学事业部副总经理：田勇 先生 光通信业务负责人：乔娟 女士 海外销售及商业拓展高级副总裁：Sinclair Vass 先生 全球光子工艺和制造服务事业部总经理：Hongyuan Liu 先生 全球销售副总裁：戴晔 先生 激光光源与应用事业部总监：高雷 先生
投资者关系活动主要内容介绍	问：公司“炬光科技 2.0”战略转型目前取得了哪些阶段性成果？ 答：公司自启动“炬光科技 2.0”战略转型以来，持续推进业务结构优化和资源配置升级，逐步形成成熟业务与战略业务双轮驱动的发展模式。成熟业务继续为公司贡献利润和现金流，战略业务重点聚焦光通信、消费电子及泛半导体制程等具有长期成长潜力的市场。

2026 年上半年，公司光通信、消费电子等战略业务保持较快增长，收入结构持续优化，进一步验证了“成熟业务支撑现金流、战略业务驱动成长”的发展路径，相关业务发展情况为公司战略转型方向提供了积极验证。未来公司将继续围绕战略方向推进能力建设和市场拓展。

问：公司光通信业务目前处于什么发展阶段？

答：近年来，在 AI 算力基础设施、高速光互联以及数据中心升级需求持续增长的带动下，公司光通信业务保持快速成长。2026 年上半年，公司光通信应用市场实现收入 6,688 万元，同比增长 215%，超过 2025 年全年，业务正逐步由前期客户验证阶段向订单增长和规模制造阶段转换。

围绕高速光互联产业链，公司已形成覆盖光学元器件、衬底材料以及高端光学装备的综合布局，并取得积极进展。

在光学元器件方面，公司围绕可插拔光模块、OCS 及 NPO/CPO 等细分市场布局多类核心光学器件。近期，公司用于可插拔光模块的相关产品成功导入新增客户；面向 NPO/CPO 应用的 V 型槽阵列产品以及用于外置激光器的耦合光学产品，均已获得客户批量订单，市场导入进展顺利。与此同时，随着 AI 数据中心网络架构升级，OCS 相关市场需求呈现快速增长趋势，公司将积极把握相关市场机会。

在衬底材料方面，公司持续推进面向硅光 CW 光源及外置激光器光源用的高性能衬底材料产品开发和客户导入。相关产品已从样品验证阶段逐步进入客户导入阶段，相关项目正按照客户导入流程持续推进。相关布局同时也是公司高速光通信激光器高性能衬底材料产业化项目的重要基础。

在测试装备方面，公司围绕高速光互联核心器件制造过程持续布局检测和制造装备能力。近期发布的节距误差测量系统在产品已获得客户订单，实现了从研发验证到商业化应用的重要突破。相关进展验证了公司在光通信产业链高端装备领域的技术能力和市场认可度。相关方向亦是公司光互联核心器件高端装备产业化项目的重要组成部分。

总体来看，公司光通信业务已不再局限于前期技术验证阶段，而是开始在光学元器件、衬底材料及装备三个方向同步取得商业化进展，逐步形成从核心器件到关键材料再到制造装备的平台化能力体系。

问：公司本次募投项目将为未来发展带来哪些支撑？

答：公司本次募集资金投资项目围绕高速光通信产业链关键环节进行布局，分别聚焦高端光互联核心光学元器件、高性能衬底材料以及光互联核心器件高端装备三个方向。

其中，高端光互联核心光学元器件项目将进一步增强公司在光学元器件产品领域的研发及规模制造能力；高性能衬底材料项目将完善公司面向硅光和外置激光器产业链的材料能力建设；高端装备项目则将推动光耦合、光测试及 AOI 等装备的产业化发展。

公司希望通过三个项目的实施，进一步完善“核心器件+关键材料+高端装备”的平台布局，提升产业链协同能力和全球竞争力，为未来长期成长奠定基础。

问：公司消费电子业务目前进展情况如何？

答：消费电子是公司重点培育的战略业务之一。公司依托晶圆级光学元器件与模组、光学模组封装服务以及半导体行业压印制造服务等平台能力，持续推进消费电子领域客户开发和项目导入。相关产品可应用于智能眼镜、智能手机、智能家居设备、智能口腔护理及其他智能感知终端。

目前，公司消费电子业务正由研发验证阶段逐步向产业化阶段推进。公司正积极推动首个消费电子量产项目进入量产阶段，标志着公司消费电子业务实现从研发验证到量产供应的关键跨越。未来，公司将以此为基础，持续推进更多消费电子项目的导入和量产。

问：公司与 ams OSRAM 的两年期制造服务协议将于 2026 年 9 月到期，协议到期后相关业务模式是否会发生变化？

	答：公司与 ams OSRAM 的两年期制造服务协议已于 2026 年 9 月到期。协议期内，公司按照协议约定持续开展制造及研发服务。协议到期后，双方合作将由协议框架下的制造服务模式转向市场化商业合作模式。 目前，双方后续合作需求保持正常推进。与协议期内以支持客户产能转移及业务承接为目标的合作模式不同，后续合作将按照市场化原则进行定价，公司将综合考虑产品类型、制造要求、订单规模及交付条件等因素进行商业化报价，并实现与公司经营目标相匹配的合理盈利水平。 公司认为，协议到期并不意味着双方合作终止，而是标志着双方合作进入更加市场化和常态化的发展阶段。未来，公司将继续依托自身制造能力和技术优势，深化与客户的业务合作，在保证业务质量和盈利能力的基础上推动相关业务持续发展。 问：公司泛半导体制程业务目前进展情况如何？ 答：泛半导体制程业务是公司重要的成熟业务之一，也是公司利润和现金流的重要来源。公司依托高功率半导体激光器、激光光学系统及相关工艺能力，持续服务于集成电路、先进显示、及 Mini/Micro LED 等领域客户。 尤其在 DRAM Wafer Annealing 应用方向，公司今年取得积极进展，不仅持续向海外客户稳定供货，在中国市场的客户拓展和项目导入方面也取得明显突破，相关产品获得客户认可。
附件清单（如有）	参与单位名称及人员姓名
日期	2026 年 9 月 1 日-9 月 30 日

参与单位名称及人员姓名:

序号	参会人	机构名称
1	曹雅倩	景顺长城
2	柴鹏飞	东方证券
3	陈宝健	上海南土资产管理有限公司
4	陈向阳	个人投资者
5	陈学武	个人投资者
6	陈云鹏	招商证券
7	程乙峰	西部证券
8	代小笛	兴证通信
9	单慧伟	华西证券
10	方城林	新华资产
11	郭若沛	西安西投资本管理有限公司
12	郭仕源	个人投资者
13	韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司
14	杭嘉麒	上海淦瀛资产管理有限公司
15	何伟	建信基金
16	贺竟萱	中信建投
17	洪烨	中国银河证券股份有限公司
18	胡英	浦发银行深圳益田支行
19	姜新月	新华资产
20	李聪	国信证券
21	李浪	新华资产
22	李慕梓	国信证券
23	李伟	个人投资者
24	李宇格	CPE 源峰基金
25	刘奇	平安基金
26	刘伟浩	招商证券
27	刘云坤	上海南土资产
28	刘芝利	华鑫证券
29	卢浩	常安汇富
30	罗璐	中鑫远科技有限公司
31	吕明晖	鑫泽投资
32	马文文	中信保诚基金
33	马骁	CPE 源峰基金
34	马玄恒	个人投资者
35	欧子兴	东吴证券
36	潘敏	九九投资
37	任泽松	上海集元资产管理有限公司
38	沈朱樱婷	国盛证券
39	师正浩	开源证券股份有限公司
40	孙悦文	中泰证券
41	涂锬山	招商证券
42	王爱琳	海通国际

序号	参会人	机构名称
43	王东辉	个人投资者
44	王霆	浙江浙商证券资产管理有限公司
45	王彦龙	国泰海通
46	魏征宇	华福证券
47	吴兆方	个人投资者
48	伍嘉琪	银之杰
49	肖思雨	国信证券资产管理有限公司
50	许盼盼	CPE 源峰基金
51	杨昕东	开源证券
52	杨亚桥	个人投资者
53	杨易	建信基金
54	叶怡豪	东北证券
55	詹浏洋	国信证券
56	张宁	西安西投资本管理有限公司
57	张文浩	建信基金
58	张文涛	颐禾基金
59	章旷怡	国盛证券
60	赵放	上海简文私募基金
61	赵中兴	银河证券
62	郑洋子	上海淦瀛资产管理有限公司
63	周众	广州市里思资产管理有限公司
64	朱婕	财通资管
65	邹国英	万海资本有限公司/上海朴信投资